

FlexTRAK[®]-2MB 等离子系统

特点和优势

- 独特的晶舟分流特点优化生产率
- 多个在线式模块提高产能
- 均匀性极高的等离子体处理技术
- 生产待料的双轨道晶舟控制
- 倒装芯片底部填充(FCUF)工艺的最佳选择

高产能在线式晶舟处理的等离子系统

FlexTRAK[®]-2MB系统专门用于晶舟、托盘或其他载具中的微电子设备的高产能，在线式处理。已获专利的等离子模块可实现优越的均匀性以及各批次加工的重复性。该系统具有先进的三轴对称性等离子体处理腔体，确保可对所有工艺参数和高度可重复性的结果进行控制。

该系统实现了无缝一体化生产线，适应于各种大小的晶舟，具有无法比拟的灵活性。该系统具有紧凑的等离子体处理腔体和专有工艺控制系统，实现周期时间最小化。

FlexTRAK-2MB系统集成的晶舟传送模块具有快速传料的能力，每个等离子体处理周期可处理多达2个晶舟。因为设计紧凑，等离子体处理周期短，该系统实现产能最大化和购买成本最小化。



应用

倒装芯片底部填充和固晶前，引线键合(焊线)、塑封前需要等离子处理。

等离子体去污和清洗

- 氟与其他卤素
- 金属和金属氧化物
- 有机化合物

等离子蚀刻

- 粗化表面，提高粘合力，降低分层
- 改善表面，增加粘结力和表面张力性能

表面活化

- 改善倒装芯片底部填充性能，尽可能减少空洞，提高粘合力及芯吸速度，尽可能提高填料两侧高度的一致性
- 提高塑封材料的流动性，消除空洞，降低焊线偏离率

规格: FlexTRAK®-2MB 等离子系统

外壳尺寸	W(宽) x (D长) x (H高) -占地面积	0.8米宽 x 1.53米长 x 1.596米高(包含灯塔高度1.95米)
	净重	590公斤 (1300磅)
	设备间隙	前面、右边、左边-607毫米, 后面-254毫米
处理腔体	最大容量	5.5升
电极	多种电极配置	电源-接地, 接地-电源, 电源-电源
	电极面积	305毫米宽 x 305毫米长(12英寸宽 x 12英寸长)
射频电源	标配功率	600 W
	频率	13.56MHz
气体控制	流量计	10、25、50、100、250或500标准毫升/分钟
	MFC最多可配置数	4
控制和接口	软件控制	外部外设控制器(EPC), 配有PC端触摸屏界面
	远程接口	SMEMA接口、SECS/GEM协议
真空泵	标配干泵	453升/分钟
	选配湿泵	552升/分钟
	选配净化干泵	453升/分钟
	干泵净化氮气用量	2升/分钟
设施	电源	220 伏交流电, 15安培, 50/60 赫兹, 1相, 12AWG, 3线
	工艺气体接口及管径	外径6.35 毫米(0.25英寸)Swagelok管
	工艺气体纯度	实验室或电子等级
	工艺气体压力	最小0.069兆帕至最大0.103兆帕, 可调节
	净化气体接口及管径	外径6.35 毫米(0.25英寸)Swagelok管
	净化气体纯度	实验室或电子等级N2/CDA
	净化气体压力	最小0.2兆帕至最大0.69兆帕, 可调节
	气动阀接口及管径	外径6.35 毫米(0.25英寸)Swagelok管
	气动气纯度	CDA、无油、露点温度 ≤7°C, 粒径<5微米
	气动气压力	最小0.345兆帕至最大0.689兆帕, 可调节
合规性	排放	外径25.4 毫米(1英寸)管道法兰
	半导体国际	通过SEMI S2/S8 (环境、健康和安全/人体工学)认证; 符合SEMI E10标准 通过CE认证
辅助设备	气体发生器	氮气、氢气 (需要其他不可选硬件)
	设施	冷却器、洗涤器

欲了解更多信息, 请访问我们的网站, 联系您当地的办事处或客服代表进行咨询。
我司在全球拥有多个服务网点。

北美洲地区 / 亚太地区 / 欧洲、中东和非洲地区
www.nordson.com/electronics
info-electronics@nordson.com

中国

苏州 +86.512.6665.2008

上海 +86.21.3866.9166

北京 +86.10.8453.6388

广州 +86.20.8722.0092

台湾 +886.2902.1860



北美总部
2747 Loker Avenue West
Carlsbad, CA 92010-6603, USA

Nordson
ELECTRONICS SOLUTIONS